

An:  
Bayern Innovativ GmbH

**Fax: +49 911-20671-766**

Ich melde mich an zu dem Kooperationsforum

**„Leistungselektronik“**

am 9. Oktober 2007 in Nürnberg

Ich melde mich an zu dem ExtreMat-Seminar

**„Novel Heat Sink Materials  
for Power Electronics Applications“**

am 10. Oktober 2007 in Nürnberg

Anmeldungen bitte bis 2. Oktober 2007, pro Person jeweils ein Formular

Bitte senden Sie mir eine Anmeldebestätigung und Rechnung  
Teilnahmegebühr siehe Veranstaltungshinweise und Vorankündigung

**Absender:** Bitte in Druckbuchstaben schreiben

\_\_\_\_\_  
Titel, Vorname, Name

\_\_\_\_\_  
Firma / Institution

\_\_\_\_\_  
Abteilung

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon, Telefax

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift

**Gesamt-  
koordination**

Bayern Innovativ GmbH  
Gewerbemuseumsplatz 2  
90403 Nürnberg  
Tel.: +49 911-20671-160  
Fax: +49 911-20671-766  
E-Mail: steinbauer@bayern-innovativ.de  
www.bayern-innovativ.de

**Tagungsort**

Maritim Hotel Nürnberg  
Frauentorgraben 11  
90443 Nürnberg

**Tagungszeit**

**Dienstag, 9. Oktober 2007**  
**10:00 – 17:00 Uhr Vorträge**  
**09:00 – 18:00 Uhr Ausstellung**

**Anmeldung**

Bitte senden Sie die Faxantwort an:  
+49 911-20671-766  
Anmeldeformular auch im Internet unter:  
www.bayern-innovativ.de/leistungselektronik07

**Anmeldeschluss**

**2. Oktober 2007**

**Teilnahme-  
gebühr**

Inkl. Tagungsunterlagen, Imbiss und  
Erfrischungsgetränke  
**€ 170,- zzgl. 19 % MwSt.**

**Anmelde-  
bedingungen**

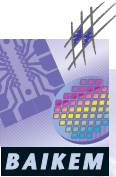
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie  
eine Anmeldebestätigung und Rechnung. Bei  
Stornierung der Anmeldung nach dem 2. Oktober  
2007 bzw. bei Nichterscheinen des Teilnehmers  
ist die gesamte Gebühr zu entrichten. Eine  
Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist  
nach Absprache möglich.

**Anfahrt**

Kostenpflichtige Parkplätze stehen im Parkhaus  
des Hotels zur Verfügung.



**Kooperationsforum  
mit Fachausstellung**



**Leistungselektronik**  
**Materialien - Komponenten - Systeme**



Bildnachweis: Semikron International GmbH, Fraunhofer Gesellschaft IHSB

www.fresh-mediagroup.de - 08/2007

**Maritim Hotel  
Nürnberg**  
**9. Oktober 2007**





Prof. Dr. Josef Nassauer  
Geschäftsführer  
Bayern Innovativ GmbH,  
Nürnberg



Dr.-Ing. Heinrich K. Heilbronner  
Vorstandsbeauftragter des  
ECEPE e.V. für Cluster  
Leistungselektronik, Nürnberg

Die Elektronik ist ein bedeutender Innovationstreiber in zahlreichen Branchen. Diese Dynamik zeigt sich auch in den Weiterentwicklungen der Leistungselektronik. Sie besitzt allgemein eine Schlüsselrolle bei Gewinnung, Verteilung und Verbrauch von Energie, von Motormanagement und Hybridtechnologie im Automobilssektor über die präzise Steuerung von Maschinen bis hin zu neuen mechatronischen Systemen im Flugzeugbau.

Die Zunahme elektronischer Funktionen erfordert dabei eine weitere Miniaturisierung der Elemente aufgrund begrenzter Bauräume. Die Zielsetzung der Energieeinsparung verlangt zudem höchste Effizienz bei der Umwandlung von mechanischer und elektrischer Energie.

Großes Innovationspotenzial liegt in der Entwicklung neuer Materialien und Verbindungstechnologien für hohe Effizienz und Leistungsdichte, aber auch für hohe Resistenz gegenüber Harsh Environments wie hohen Temperaturen oder starken Erschütterungen. Fortschritte der Mikrotechnologie bei der Fertigung von Leistungshalbleitern und in der Systemintegration ermöglichen zudem weitere Miniaturisierung für die Hochleistungselektronik.

Vor diesem Hintergrund konzipiert und organisiert die Bayern Innovativ GmbH im Rahmen der Bayerischen Innovations- und Kooperationsinitiative BAIKEM (Elektronik/Mikrotechnologie) das Kooperationsforum „Leistungselektronik“ in Zusammenarbeit mit dem Cluster Leistungselektronik, dem ECPE e.V., dem Fraunhofer Institut IISB und mit Unterstützung des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie. Mit eingebunden sind die Cluster Neue Werkstoffe und Mechatronik.

Führende Experten aus Wissenschaft und Industrie berichten über aktuelle Trends in der Leistungselektronik, von Potenzialen neuester passiver Bauelemente, über Erfahrungen mit neuen Materialien und Verbindungstechnologien für höchste Leistungsdichten sowie über konstruktive Ansätze für thermisches Management bis hin zu Beispielen hochintegrierter mechatronischer Systeme für die Luftfahrt als einem der Technologieführer in diesem Sektor.

Wir würden uns freuen, Sie in Nürnberg begrüßen zu können.



Prof. Dr. Josef Nassauer



Dr.-Ing. Heinrich K. Heilbronner

## Kooperationsforum mit Fachausstellung Leistungselektronik Materialien - Komponenten - Systeme

**ab 09:00** Check-In und Besuch der Ausstellung

**10:00 – 10:15** Begrüßung und thematische Einführung

**Prof. Dr. Josef Nassauer**

Geschäftsführer, Bayern Innovativ GmbH,  
Nürnberg

**10:15 – 10:30** Chancen und Herausforderungen  
in der Leistungselektronik

**Dr.-Ing. Heinrich K. Heilbronner**

Vize-Präsident und Vorstandsbeauftragter für das  
Cluster Leistungselektronik, European Center for  
Power Electronics e. V., Nürnberg

**10:30 – 11:00** Aufbau und Verbindungstechnologien  
für hohe Leistungsdichte

**Peter Beckedahl**

Leiter Forschung & Entwicklung  
Semikron International GmbH, Nürnberg

**11:00 – 11:30** Potenzial passiver Bauelemente - hohe  
Leistungsdichte in Harsh Environments

**Reinhard Sperlich**

Murata Elektronik GmbH, Nürnberg

**11:30 – 12:00** Innovative Materialien und Komponenten  
für hochkompakte, systemintegrierbare  
Leistungselektronik

**Dr. Martin März**

Abteilungsleiter Leistungselektronische Systeme,  
Fraunhofer Institut für Integrierte Systeme und  
Bauelementetechnologie-IISB, Erlangen

**12:00 – 13:30** Mittagspause

**13:30 – 13:55** Hochintegrierte mechatronische  
Antriebssysteme

**Dr. Andreas Lelkes**

Leiter Entwicklung, GEFEG-NECKAR  
Antriebssysteme GmbH, Gosheim

**13:55 – 14:20** Hochintegrierte elektrische Aktuatoren  
für die Luftfahrt

**Dr. Peter Jänker**

EADS - Corporate Research Center, München

**14:20 – 14:45** Mechatronische Integration  
in Luftfahrtsystemen  
(„More Electric Aircraft“)

**Jochen Koszescha**

Management / Forschung & Vorentwicklung,  
Liebherr-Elektronik GmbH, Lindau

**14:45 – 15:45** Kaffeepause in der Ausstellung

**15:45 – 16:10** Effiziente Kühlungsverfahren in der  
Leistungselektronik

**Dr. Gerhard Mitic**

Power Electronics & Energy Management,  
Siemens AG Corporate Technology, München

**16:10 – 16:35** Carbonwerkstoffe für effizienteres  
thermisches Management

**Dr. Walter Thiele**

Technology & Innovation, SGL CARBON GmbH,  
Bonn

**16:35 – 17:00** Keramik-Kühlkörper als  
Schaltungsträger?

**Dr. Claus Peter Kluge**

Leiter Geschäftsentwicklung,  
CeramTec AG, Markredwitz

**Ab 17:00** Get-together in der Ausstellung